

东方证券承销保荐有限公司

关于烟台德邦科技股份有限公司

2024年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规的规定，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“东方投行”）作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“德邦科技”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的保荐机构，负责德邦科技持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与德邦科技签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解德邦科技业务情况，对德邦科技开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2024年上半年度德邦科技在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2024年上半年度德邦科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	2024年上半年度，保荐机构督导德邦科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促德邦科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对德邦科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，德邦科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促德邦科技依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不	保荐机构对德邦科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

序号	工作内容	持续督导情况
	予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2024年上半年度持续督导期间内，德邦科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2024年上半年度持续督导期间内，德邦科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2024年上半年度持续督导期间内，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2024年上半年度持续督导期间内，德邦科技未发生上述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐人应当自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	保荐机构制定了对德邦科技的现场检查工作计划，并明确了现场检查工作要求，德邦科技不存在需要进行专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的主要风险因素如下：

（一）产品迭代与技术开发风险

公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，产品广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。公司所处行业领域技术升级及产品更新迭代速度较快，且公司面临的竞争对手主要为国际知名企业。公司需要持续研发符合客户需求的新型产品，并与竞争对手展开技术

竞争，对公司的研发创新能力、研发响应速度、现有储备技术与行业新需求的匹配性构成一定挑战。

如果公司不能准确地把握下游行业的发展趋势，或者公司的研发创新能力、研发响应速度、现有储备技术无法满足客户对于新型封装工艺和应用场景的需求，或在与竞争对手的直接技术竞争中处于劣势，这将导致公司产品与下游客户的技术需求适配性下降，进而对公司的产品销售、业务开拓和盈利能力造成不利影响。

（二）关键技术人员流失风险

高端电子封装材料行业属于技术密集性行业，关键技术人员是公司获得持续竞争优势的基础，也是公司持续进行技术创新和保持竞争优势的主要因素之一。未来如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势，或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行，公司将无法引进更多的高端技术人才，甚至可能出现现有关键技术人员流失的情形，进而对公司生产经营产生不利影响。

（三）核心技术泄密的风险

公司拥有多项与电子级粘合剂制备与功能性薄膜材料制程相关的核心技术，公司的主要研发竞争力在于产品配方的持续研发创新以及工艺流程的优化改进。若公司产品配方与工艺流程被复制或泄露，公司的市场竞争力将受到不利影响。

（四）经营风险

公司产品主要应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域，并以智能终端封装、新能源应用为主，集成电路封装领域占比较低。为满足下游客户需求，公司需要持续进行产品研发及升级迭代，如果未来公司集成电路封装材料的研发效果及产品技术水平未能达到下游客户要求，或者产品研发进度落后于主要竞争对手，或者产品的市场推广进度未及预期，公司集成电路封装材料的收入占比存在持续偏低甚至下降的风险。

2024年上半年，公司营业收入为46,297.54万元，保持持续稳定增长。与国内外主要竞争对手相比，公司的经营规模相对较小，抵御经营风险的能力相对偏弱。公司当前业务经营能力仍相对有限，在市场销售、研发投入等方面仍有不足，面对日益增长的客户需求，可能无法承接所有客户的订单需求，因而错失部分业务机会，导致公司营业收入的增速存在放缓的可能。

（五）财务风险

按照应用领域、应用场景不同，公司产品包括集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。报告期内，公司业务整体发展迅速，但不同类别产品的毛利率水平主要受所处行业情况、市场供求关系、产品技术特点、产品更新迭代、公司销售及市场策略等因素综合影响而有所差异。

由于公司各产品面临的市场竞争环境存在差异，各产品所在的生命周期阶段及更新迭代进度不同，产品的销售结构不同，且同一产品的单位成本金额亦持续受到原材料价格变化的影响，公司存在因上述因素导致的毛利率下降的风险。若公司未能根据市场变化及时进行产品技术升级，产品技术缺乏先进性，或公司市场推广未达预期，造成高毛利产品销售增速放缓、收入占比下降，或因原材料价格大幅上涨，可能导致公司毛利率水平进一步下降，进而对公司经营业绩及盈利能力产生不利影响。

报告期内，公司享受高新技术企业、研发加计扣除等企业所得税优惠政策，如果国家有关高新技术企业等税收优惠的法律、法规、政策发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法获得税收优惠，将对公司经营业绩造成不利影响。

报告期内，公司计入损益的政府补助金额为773.82万元（包括增值税加计扣除金额）。如果未来政府部门对相关产业的政策支持力度减弱，或者其他补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助将会减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（六）行业风险

在集成电路领域，公司主要业务是面向下游封装测试及终端客户提供集成电路封装的各类材料。目前国内市场的大部分先进封装材料由外资厂商占据主导地位，国产化率仍然处于较低水平，国产替代空间广阔。倘若受制于各类外部因素影响，封装材料的国产替代进程缓慢或受阻，则会对公司经营业绩产生不利影响。

在智能终端领域，报告期内虽然公司下游所处的消费电子已经开始进入温和复苏阶段，短期消费电子终端需求回暖。但中长期来看，市场更加关注下游巨头的新品发布能否加速行业的创新周期的来临。倘若AI对智能终端的赋能效果不及预期，导致手机、PC的换机节奏放缓；同时新的硬件形态（XR、折叠机）探索反馈也不太理想的情况下公司经营业绩可能会出现不利影响。

在新能源领域，随着国内新能源汽车市场由政策导向型切换为市场驱动型，更加充分的市场竞争导致行业的盈利空间受到了挤压，行业整体盈利水平呈现下行趋势，终端客户为保证自身盈利空间，将降价压力向上传导至上游供应链企业。虽然公司采取了大宗采购、技术降本、自动化生产等各类措施积极应对，但短期内无法完全对冲降价带来的冲击，因此增加了新能源业务板块毛利率出现短期大幅波动的风险。

（七）宏观环境风险

封装材料作为一个已充分竞争的行业，近年来行业集中度有所提高，但国内企业产品依然以中低端为主，世界知名品牌跨国公司在品牌及技术具有先发优势，不断通过在国内建立合资企业或生产基地降低生产成本，使得公司面临一定的市场竞争风险。其次国内环保政策、国际贸易保护等有可能导致原材料价格上涨、断供或产品出口受限等风险。尽管公司目前主营业务所处市场发展趋于良性循环，但国际贸易环境更趋复杂严峻和不确定，国内宏观经济增长不及预期或行业政策重大调整对公司下游行业产生不利影响，也将使公司也面临着各种风险及挑战。

四、重大违规事项

2024年上半年度持续督导期间内，德邦科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年上半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	462,975,364.20	394,652,293.69	17.31%
归属于上市公司股东的净利润	33,710,727.09	50,450,050.17	-33.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,857,375.54	43,671,765.93	-33.92%
经营活动产生的现金流量净额	184,143,829.32	-21,898,641.55	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,241,553,275.02	2,270,384,327.59	-1.27%
总资产	2,683,335,788.45	2,740,678,337.69	-2.09%

2024年上半年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
--------	------	------	----------------

基本每股收益（元 / 股）	0.24	0.35	-31.43%
稀释每股收益（元 / 股）	0.24	0.35	-31.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.20	0.31	-35.48%
加权平均净资产收益率（%）	1.49	2.26	减少0.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.28	1.96	减少0.68个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	5.70	5.54	增加0.16个百分点

六、核心竞争力的变化情况

（一）研发、生产优势

公司专注于高端电子封装材料的研发和产业化，公司深知高端电子封装材料的技术研发和新产品开发能力对企业持续经营的重要性，因此积极布局集成电路、智能终端、新能源等前沿领域。在国家高层次海外引进人才领衔的核心科研团队长期钻研下，公司在集成电路封装、智能终端封装、新能源应用等领域实现技术突破，在高端电子封装材料领域构建起了完整的研发体系，掌握核心技术并拥有完全自主知识产权。公司先后承担了“02专项”、“国家重点研发计划”和“高质量发展专项”等多个国家级重大科研项目。

公司始终坚持以自有技术建立自有品牌为目标，通过自主开发掌握了行业内领先的配方技术和工艺技术，并通过持续不断的改进，确保工艺的成熟稳定、产品性能的持续提升；通过关键材料的结构设计自主合成，在确保成本优势的基础上提升公司核心竞争力；通过联合实验室共建、人才双向流、标准共建等产学研活动的开展，实现企业与高校的优势互补与协同创新。经过多年的技术积累，公司已建立起较为完备的高端电子封装材料产品体系，并与行业领先客户建立长期合作关系，凭借强大的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，进入到知名品牌客户的供货体系，并成为客户信赖的合作伙伴；公司紧跟行业趋势，通过持续的研发投入、人才的持续引入和创新，不断提升研发能力，巩固核心竞争力，保持了技术领先和产品迭代的优势，以应对日益激烈的市场竞争，实现可持续发展。

与此同时，公司产品种类多、覆盖领域广，针对不同的产品体系和行业特征，公司建立了多种生产模式以满足不同客户的需求，既有小批量、多批次的生产单元，又有大规模、智能化的制造工厂，结合BIP+IMS先进智能制造、WMS智能物流系统，能够

根据公司订单情况、各设备生产能力及生产负荷，科学高效安排生产和物料配送，提高公司生产效率、降低生产成本。

公司具备快速的市场响应能力，公司下游应用领域存在较为明显的产品周期短、技术更新换代快、消费热点切换迅速的特点，这就要求上游材料供应商具有快速研发能力，以适配客户的产品工艺需求。公司所面向的客户主要为行业内知名品牌客户，下游客户对于供应链管理极为严格，一般要求即时发货，采购周期较短。公司已建造了行业领先的高端电子封装材料智能制造工厂，并拥有一批对行业、产品理解深刻的生产队伍，生产管理水平较高，能够配合客户的实时订单要求，迅速组织生产，实现供货。

（二）客户资源优势

高端电子封装材料，作为终端产品内部构件性能、稳定性及结构密封防护的关键要素，对于终端产品品质有着决定性的影响。因此，原材料的品质成为终端产品品牌商选择供应商时的核心考量因素，进入其供应商名录门槛颇高。随着下游高端应用领域的蓬勃发展，公司紧密围绕客户需求，开发细分产品，确保供应商地位的稳固，构筑起坚实的市场壁垒。

多年来，公司凭借卓越的技术实力，成功将芯片固晶材料、晶圆UV膜等集成电路封装材料批量供应给国内知名封测企业，包括了华天科技、通富微电、长电科技、日月新等全球知名封测厂商；智能终端封装材料亦广泛应用于国内外知名品牌，包括苹果公司、华为公司、小米科技等智能终端领域的全球龙头企业；同时，宁德时代、中创新航、比亚迪、通威股份、阿特斯等新能源领域的知名企业亦成为公司的合作伙伴。公司与这些行业领先客户建立长期合作关系，进入客户的供应链体系，通过高质量的产品及服务不断增强客户粘性，这些优质客户资源为公司的发展提供了强有力的支撑。

为深化与客户合作，公司不断加强与终端应用品牌的技术交流，精准把握市场脉动和技术趋势，确保研发方向与产品迭代升级紧扣市场需求。公司依托核心技术，向客户提供高端电子封装材料及其解决方案，将技术与客户资源双重优势融合，进一步巩固市场地位，提升竞争力，引领行业发展。

（三）丰富的系统解决方案优势

公司在提供高性能产品的同时，更凭借扎实的技术研发实力和深厚的专有技术积累，为客户提供全方位的系统解决方案。公司多年积累的研发和应用数据库，能够实现更加精准高效研发。

从产品设计之初到生产应用培训，再到持续的售后服务与产品技术迭代，公司始终坚持以客户需求为核心，致力于提供一站式的高端电子封装材料解决方案。公司深入参与客户新产品设计的各个阶段，提供包括性能提升方案、材料配方设计、样品测试在内的全面服务。通过定制化服务，精准解决客户的个性化问题，实现与客户的协同作业，从而大幅提升客户满意度，并深化与下游客户的合作关系。在高端电子封装材料领域，产品性能受多种因素影响。因此，公司紧密与客户合作，共同设计出满足特定工艺参数、胶体特性、使用环境、老化参数和可靠性要求的产品解决方案。这种以客户需求为导向的服务模式，使公司能够不断优化产品性能，满足市场对高质量封装材料的复杂需求。

公司丰富的系统解决方案优势不仅体现在技术实力上，更体现在对客户需求的深度理解和满足上。这种优势不仅提升了客户的满意度和合作深度，更巩固了公司在高端电子封装材料领域的市场领先地位。

七、研发支出变化及研发进展

(一)研发支出及变化情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	26,369,663.24	21,857,330.13	20.64
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	26,369,663.24	21,857,330.13	20.64
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.70	5.54	增加0.16个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	不适用

(二)研发进展

公司通过多年的自主研发，已经具备了完整的自主知识产权体系，截至2024年6月30日，公司拥有发明专利319个、实用新型专利42个、软件著作权6个。上述专利涵盖了公司产品的各个关键技术领域，体现了公司在技术研发、设计环节的核心竞争力。截至2024年6月30日，公司知识产权情况如下：

项目	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	4	11	722	319
实用新型专利	1	1	43	42
外观设计专利	0	0	1	1
软件著作权	0	0	6	6
其他	3	3	3	3
合计	8	15	775	371

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

(一) 募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额 (元)
募集资金到账验资金额	1,504,132,893.44
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	7,283,018.76
支付发行费用	9,366,625.80
募集资金净额	1,487,483,248.88
减：募投项目投入	453,222,739.75
超募部分永久补充流动资金	406,000,000.00
加：扣除手续费后利息收入和理财收益	25,606,317.92
使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额	334,790,000.00
截止2024年6月30日募集资金专户余额	319,076,827.05

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额 (元)
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410968	1,032,453.48
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410266	18,096,984.20
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410906	535,548.31
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410508	381,037.78

开户银行	账号	募集资金余额（元）
招商银行股份有限公司昆山支行	512910748910966	2,398,637.31
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	1265600000901666	59,512.61
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100862080	1,066,978.26
中国光大银行烟台经济技术开发区支行	38080188000258467	7,424,120.78
中信银行股份有限公司烟台自贸区支行	8110601011601495861	46,801.14
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	1265600000931613	91,067.23
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410616	207,544,455.44
中国光大银行股份有限公司烟台九隆支行	38090188000191019	2.03
招商银行股份有限公司烟台分行	535904836910706	51,002,813.95
合计	/	319,076,827.05

（二）募集资金是否合规

报告期内，公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2024年6月30日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员持有公司股份的情况如下：

单位：万股

姓名	职务	直接持股数	间接持股数	合计持股数	持股比例
解海华	董事长	1,506.42	498.94	2,005.36	14.10%
陈田安	董事、总经理、核心技术人员	309.33	-	309.33	2.17%
王建斌	董事、副总经理、核心技术人员	866.11	-	866.11	6.09%

姓名	职务	直接持股数	间接持股数	合计持股数	持股比例
林国成	董事（离任）	1,320.82	-	1,320.82	9.29%
杨柳	董事	-	-	-	-
王艺涵	董事	-	-	-	-
杨德仁	独立董事	-	-	-	-
唐云	独立董事	-	-	-	-
宋红松	独立董事	-	-	-	-
李清	监事	-	6.19	6.19	0.04%
陈丽	监事	-	6.68	6.68	0.05%
赵倩	监事	-	-	-	-
陈昕	副总经理	173.22	-	173.22	1.22%
于杰	副总经理、董事会秘书、财务总监	-	389.75	389.75	2.74%
徐友志	副总经理、核心技术人员	-	-	-	-
姜贵琳	核心技术人员	-	7.42	7.42	0.05%
潘光君	核心技术人员	-	3.71	3.71	0.03%
姜云	核心技术人员	-	0.74	0.74	0.01%
合计		4,175.90	913.43	5,089.33	35.78%

截至 2024 年 6 月 30 日，董事长解海华所持公司 75.00 万股股份存在被司法冻结的情形，公司已于 2023 年 6 月 2 日发布《烟台德邦科技股份有限公司关于股东所持公司部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2023-024）对相关信息进行披露。除此之外，上述其他人员持有的德邦科技股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

此外，公司于 2023 年 6 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。截至 2024 年 6 月 30 日，公司部分董事、高级管理人员、核心技术人员获授予第二类限制性股票，但该等股票尚未归属该等人员直接持有，具体如下表所示：

姓名	职务	期末已获授予限制性股票数量
解海华	董事长	200,000
陈田安	董事、总经理、核心技术人员	323,000
王建斌	董事、副总经理、核心技术人员	274,000

陈昕	董事、副总经理	258,000
于杰	副总经理、董事会秘书、财务总监	265,000
徐友志	副总经理、核心技术人员	132,800
姜贵琳	核心技术人员	114,800
姜云	核心技术人员	67,300
潘光君	核心技术人员	64,300
合计	/	1,699,200

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《东方证券承销保荐有限公司关于烟台德邦科技股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人:

王国胜

王国胜

李天雄

李天雄



东方证券承销保荐有限公司

2024年8月23日